

## MULTICELLS

<b>GROUPE(S) CONCERNE(S)</b>	<b>NBS</b>
<b>REFERENCE COMTEAM</b>	<b>NBS-08-11</b>
<b>REFERENCE DANS RTB LIMS</b>	<b>P-13-00226</b>

<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	
Porteur du projet (Nom, prénom)	Leichle, Thierry
Coordinateur TEAM (Nom, prénom)	Mazenq, Laurent

<b>FINANCEMENT(S) DU PROJET</b> (Un projet peut avoir plusieurs origines préciser TOUS les supports)			
<b>ORGANISME</b> (ANR, Europe, Carnot, etc.)	<b>NOM DE L'APPEL</b> (Pnano, 7 <sup>eme</sup> PCRD, blanc, etc.)	<b>NOM DU CONTRAT SUPPORT</b>	<b>POUR 2014 sommes mises à disposition pour les réalisations technologiques</b>
<b>ANR</b>	<b>Blanc</b>	<b>MultiCells</b>	1000

<b>BILAN</b>			
<b>En avance</b>	<b>A jour</b>	<b>En retard</b>	<b>Terminé</b>
	<b>X</b>		

<b>Raisons d'un éventuel retard</b>			
Non démarré	Développements procédés	Disponibilité de personnel	Disponibilités d'équipements

Réalisation de puces types « Bioplumes ». Ces dispositifs reposent sur l'utilisation d'un procédé déjà développé dans la salle blanche du LAAS.

<b>PROCEDES</b>
-----------------

**DESCRIPTION DES ETAPES DU(ES) PROCEDE(S) A VENIR (PROJET EN COURS) OU FINALISE (PROJET TERMINE) :**

1. GRAVURE FACE AVANT POUR LA MISE EN FORME DES LEVIERS
2. METALLISATION CONFORME POUR LA FABRICATION D'ELECTRODES POUR L'ELECTROCHIMIE
3. GRAVURE FACE ARRIERE POUR LA LIBERATION DES LEVIERS

		NATURE PROCEDES Mettre une croix dans la ou les colonnes adaptées			NATURE DES TRAVAUX
		ETABLIS	DEVELO PPEMENTS	FORMATIONS (Nb personnes)	Préciser notamment la nature des verrous (Exemple : litho laser : réalisation de masques / photolithographie : procédés classiques / gravure plasma : gravures classiques + développement de la gravure nanométrique dans du polymèreXXx)
LITHOGRAPHIE LASER masques /Ecriture					
PHOTOLITHOGRAPHIE		x			
LITHOGRAPHIE ELECTRONIQUE					
TRAITEMENT THERMIQUE		x			
DEPOTS SOUS VIDE		x			
ELECTROCHIMIE	Croissances				
	Photolithographie moules				
GRAVURE HUMIDE KOH, TMAH					
GRAVURE PLASMA		x			
CHIMIE Attaques/ Nettoyages/ Divers		x			
JET D'ENCRE Procédés à développer					
EJM Durée (en heures étalonnages compris)					
NANO IMPRINT UV Procédés à développer					
IMPLANTATION					
ASSEMBLAGE	Montages de puces	x			
	Wafer Bonding, CMP, sérigraphie, ...				
CARACTERISATION Formations					